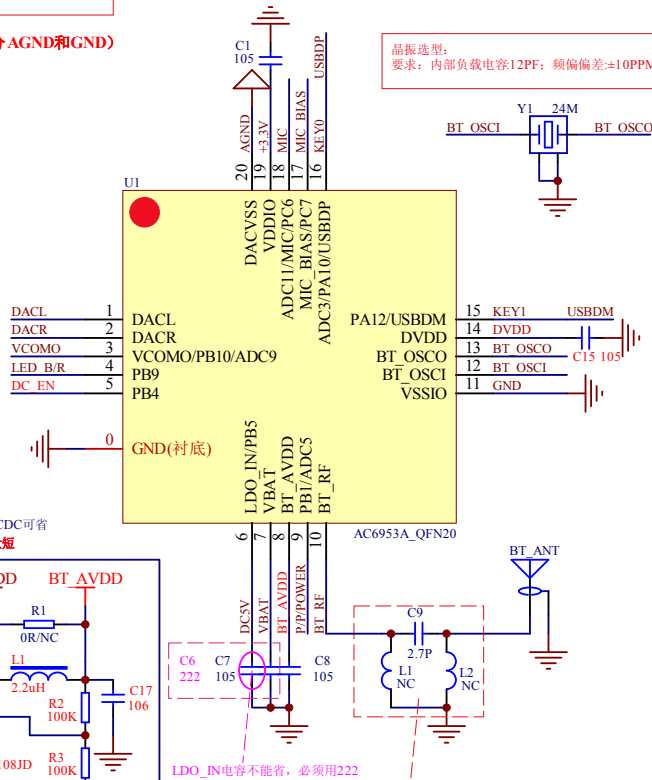


备注：
1、VBAT、LDO_IN必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、VDDIO、VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
所有电容请使用原装电容，以保证容值。

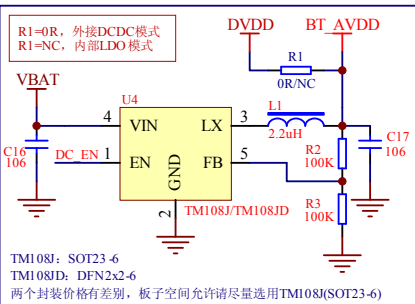
注意：PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）

VBAT T1 VBAT
USBDM T2 DM
USBDP T3 DP
GND T4 GND
+3.3V T5 VDDIO

一指多PC烧录预留焊点：
VBAT、VDDIO、DP、DM、GND



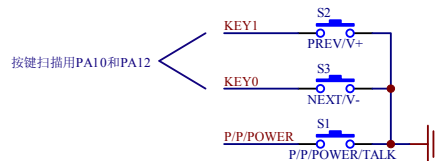
若方案接受芯片内部LDO模式功耗，外置DCDC可省
电感要靠近DC-DC芯片放置，SW走线要尽量短



LDO_IN电容不能省，必须用222

备注：天线匹配电路参数，以实际样机调试结果为准。

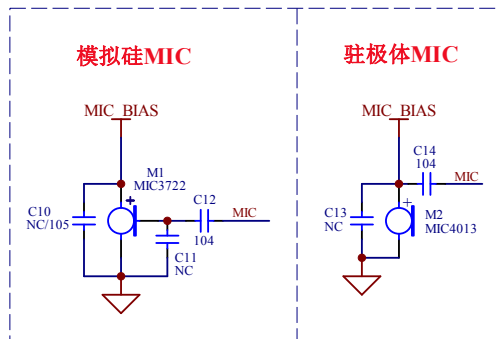
MCU



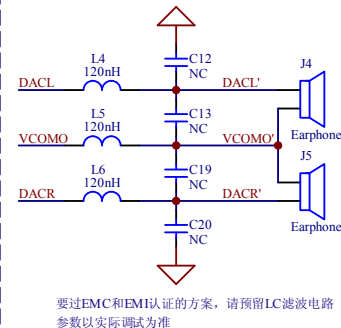
KEY

备注：

1、硅麦：一致性好，灵敏度高，抗干扰能力强，通话效果好



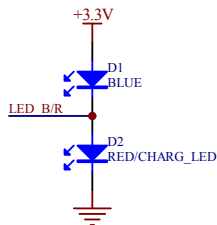
MIC电路处的滤波电容位置需预留



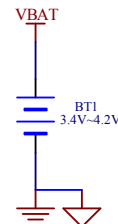
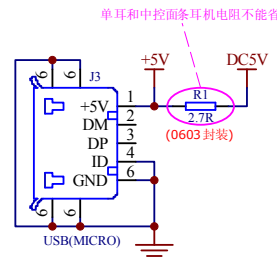
要过EMC和EMI认证的方案，请预留LC滤波电路参数以实际调试为准



Mic、Earphone



LED



备注：
1、GND、AGND在电池地短接在一起！
2、电池必须使用带保护板的电池

POWER